



世界先進積體電路股份有限公司

公開說明書

(發行 112 年度國內第 1 次無擔保普通公司債)

- 一. 公司名稱：世界先進積體電路股份有限公司
- 二. 本公開說明書編印目的：發行 112 年度國內第 1 次無擔保普通公司債。
- 三. 發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
 - (1) 種類：無擔保普通公司債。
 - (2) 金額：新臺幣陸拾億元整。
 - (3) 利率：本公司債票面利率為甲券固定年利率 1.68%，乙券固定年利率 1.75%。
 - (4) 發行條件：
 1. 名稱：世界先進積體電路股份有限公司 112 年度國內第 1 次無擔保普通公司債。
 2. 發行總額：新臺幣陸拾億元整；依發行期限之不同分為甲、乙券。
甲券五年期，發行金額新臺幣貳拾億元整；乙券七年期發行金額新臺幣肆拾億元整。
 3. 票面金額：新臺幣壹仟萬元整壹種。
 4. 發行期限：本公司債各券發行期限分別為甲券五年期及乙券七年期。發行期間分別為：
甲券自民國 112 年 09 月 25 日發行，至民國 117 年 09 月 25 日到期；
乙券自民國 112 年 09 月 25 日發行，至民國 119 年 09 月 25 日到期。
 5. 發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
 6. 還本方式：本公司債各券皆自發行日起屆滿到期日乙次償還本金。
 7. 計、付息方式：本公司債各券皆自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次；計息基礎依實際天數/該年度實際總日曆天數計算。每壹仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
 8. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
 9. 債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 - (5) 公開承銷比例：百分之百對外公開承銷。
 - (6) 承銷及配售方式：委託承銷商對外公開承銷(洽商銷售)。
 - (7) 銷售對象：本公司債之銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四. 本次資金運用計畫之用途及可能產生效益概要：資金用途為擴建廠務設施及購買機器設備等資本支出；預計產生之效益為支應產能擴充及因應產品組合調整以增加公司整體營運效益，請參閱本公開說明書參、資金用途。
- 五. 本次發行之相關費用：
 - (1) 承銷費用：新臺幣 6,000 仟元整。
 - (2) 其他費用：約新臺幣 287 仟元整。
- 六. 有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八. 股票面額：每股面額新臺幣 10 元整。
- 九. 投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 十. 查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

世界先進積體電路股份有限公司 編製

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新臺幣仟元；%

資 本 來 源	金 額	佔實收資本額比率
設 立 募 集 資 金	14,002,008	85%
現 金 增 資	12,791,933	78%
盈 餘 轉 增 資	2,599,140	16%
資 本 公 積 轉 增 資	51,015	0%
合 併 增 資	564,877	4%
減 資	(14,683,783)	(90%)
其 他	1,064,633	7%

二、公開說明書之分送計劃：

- (一) 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱
 (二) 分送方式：依證券主管機關之規定辦理
 (三) 索取處所：請附回郵信封向本公司索取或逕洽公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)

三、公司債承銷商名稱、地址、網址及電話：

名 稱	凱基證券股份有限公司	網 址	https://www.kgiworld.com.tw
地 址	台北市明水路 700 號 3 樓	電 話	(02)2181-8888

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中國信託商業銀行股份有限公司	網 址	https://www.ctbcbank.com
地 址	台北市南港區經貿二路 168 號	電 話	(02)3327-7777

六、公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中國信託商業銀行股份有限公司	網 址	https://www.ctbcbank.com
地 址	台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	電 話	(02)6636-5566

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中華信用評等股份有限公司	網 址	http://www.taiwanratings.com
地 址	台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓	電 話	(02)2175-6800

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會 計 師 姓 名	葉東輝會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www.deloitte.com.tw		
律師事務所名稱	一誠聯合法律事務所		
律 師 姓 名	郭惠吉律師		
地 址	台北市大安區信義路三段 106 號 9 樓之 4	電 話	(02)2325-3748
網 址	無		

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會 計 師 姓 名	葉東輝、黃裕峰會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www.deloitte.com.tw		

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名	黃 惠 蘭	代理發言人姓名	葉 慶 煌
職 稱	副總經理暨財務長	職 稱	人力資源副總經理
電 話	(03)5770355	電 話	(03)5770355
電子郵件信箱	VIS_PR@vis.com.tw	電子郵件信箱	VIS_PR@vis.com.tw

十三、公司網址：<http://www.vis.com.tw>

目 錄

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料-----	1
貳、發行辦法-----	2
參、資金用途-----	3

附錄一、本次發行公司債之董事會議事錄節錄本

附錄二、證券承銷商總結意見

附錄三、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理，應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

世界先進積體電路股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新臺幣 16,389,823 仟元		公司地址：新竹科學園區新竹縣園區三路 123 號		電話：(03)577-0355
設立日期：83 年 12 月 05 日		網址：https://www.vis.com.tw		
上市日期：不適用		上櫃日期：87 年 03 月 25 日	公開發行日期：85 年 05 月 13 日	管理股票日期：無
負責人：董事長 方 略			發 言 人：黃 惠 蘭 (副總經理暨財務長) 代理發言人：葉 慶 煌 (人力資源副總經理)	
股票過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司		電話：(02)6636-5566	網址：https://www.ctbcbank.com	
		地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓		
股票承銷機構：不適用		電話：(02)2181-8888	網址：https://www.kgieeworld.com.tw	
債券承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商		地址：台北市明水路 700 號 3 樓		
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所		電話：(02)2725-9988	網址：http://www.deloitte.com.tw	
葉東輝、黃裕峰		地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓		
複核律師：不適用		電話：-	網址：-	
		地址：-		
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司		電話：(02) 2175-6800	網址：http://www.taiwanratings.com	
		地址：台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓		
評等標的	發行公司：世界先進積體電路股份有限公司 無□；有■，評等日期：112 年 4 月 27 日			
	評等等級：twA+			
	本次發行公司債：112 年度 無■；有□，評等日期：- 評等等級：-			
國內第 1 次無擔保普通公司債				
董事選任日期：110 年 8 月 13 日(任期：三年)		監察人選任日期：不適用		
全體董事持股比例：45.04% (112 年 7 月 31 日)		全體監察人持股比例：不適用		
董事、監察人及持股 10%以上股東及其持股比例：(112 年 7 月 31 日)				
	職稱	姓 名	持 股 比 率	備 註
	董事長	方 略	28.32 %	台灣積體電路製造(股)公司法人代表
	副董事長	曾繁城	28.32 %	台灣積體電路製造(股)公司法人代表
	董事	蘇來守	16.72 %	行政院國家發展基金管理會代表人
	董事	魏永篤	0.00 %	
	獨立董事	史欽泰	0.00 %	
	獨立董事	劉文正	0.00 %	
	獨立董事	金聯舫	0.00 %	
工廠地址：公司總部及晶圓一廠		新竹科學園區園區三路 123 號	電話：(03)577-0355	
晶圓二廠		新竹科學園區力行路 9 號	電話：(03)563-2111	
晶圓三廠		桃園縣蘆竹市長興村 14 鄰長榮路 168 號	電話：(03)311-6111	
晶圓五廠		新竹科學園區力行二路 1-1 號	電話：(03)566-3111	
主要產品： 依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。 提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。 提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。			市場結構： 內銷 57%、外銷 43%	參閱本文之頁次 不適用
風險事項		不適用		
		參閱本文之頁次 不適用		
去(111)年度		營業收入： 51,694,310 仟元 買賣業：- 加工業：- 製造業： 51,694,310 仟元 稅前純益： 18,851,172 仟元 每股盈餘：9.07 元(稅後稀釋)		
本次募集發行有價證券 種類及金額		種類：無擔保普通公司債；發行金額為新臺幣陸拾億元整		
發行條件		甲券五年期，票面利率 1.68%，金額新臺幣貳拾億元；到期乙次償還本金 乙券七年期，票面利率 1.75%，金額新臺幣肆拾億元；到期乙次償還本金(參閱本文 第 2 頁貳、發行辦法)		
募集資金用途及預計產生 效益概述		資金用途：擴建廠務設施及購買機器設備等資本支出。 預計產生效益：支應產能擴充及因應產品組合調整增加公司整體營運效益(請參閱本 文第 3 至 7 頁參、資金用途)。		
本次公開說明書編印日期： 112 年 9 月 14 日		刊印目的： 發行 112 年度國內第 1 次無擔保普通公司債		
其他重要事項之扼要說明及參閱本文頁次：請參閱本公開說明書之目錄。				

註：如最近年度簽證會計師與現任簽證會計師不同者，尚應列示刊印時現任簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話等資訊

貳、發行辦法

世界先進積體電路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11200098561 號函申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額新臺幣陸拾億元整，依發行期限之不同分為甲、乙券。甲券五年期，發行金額新臺幣貳拾億元整；乙券七年期，發行金額新臺幣肆拾億元整。
- 三、票面金額：本公司債票面金額新臺幣壹仟萬元整。
- 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期限：本公司債甲券發行期限五年期，乙券發行期限七年期。發行期間分別為：
甲券自民國 112 年 09 月 25 日發行，至民國 117 年 09 月 25 日到期；
乙券自民國 112 年 09 月 25 日發行，至民國 119 年 09 月 25 日到期。
- 六、票面利率：本公司債甲券票面利率固定年利率 1.68%；乙券票面利率固定年利率 1.75 %。
- 七、還本方式：本公司債各券皆自發行日起屆滿到期日乙次償還本金。
- 八、計付息方式：本公司債各券皆自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次；計息基礎依實際天數/該年度實際總日曆天數計算。每壹仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由中國信託商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間簽訂之受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司代理部代理還本付息事宜及製作扣繳憑單寄發與債權人，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。
- 十三、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、銷售對象：本公司債之銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 十五、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。

參、資金用途

一、發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源：

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：不適用
2. 本計畫所需資金總額：新臺幣 9,000,000 仟元整(本公司為持續擴建廠務設施及購買機器設備以支應產能擴充與因應產品組合調整等資本支出以增加公司整體營運效益，此一產能持續性發展計畫，預估整體資本支出為新臺幣 9,000,000 仟元)。
3. 資金來源：發行 112 年度國內第 1 次無擔保普通公司債，不足之部分將借款或籌資方式支應
4. 計畫項目及預定運用進度：

(1) 本次募資計畫項目及預定運用進度：

單位：新臺幣佰萬元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度													
			112 年度		113 年度				114 年度				115 年度			
			Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
擴建廠務設施及購置機器設備等資本支出	115 年第 4 季	6,000	1,000	500	400	400	400	300	400	400	400	300	400	400	400	300
合計		6,000	1,000	500	400	400	400	300	400	400	400	300	400	400	400	300

註：上述預定資金運用進度表係以本次募集公司債新臺幣 6,000,000 千元為編製基礎。

(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定，應揭露事項：

1. 公司名稱：世界先進積體電路股份有限公司。
2. 公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣陸拾億元整，依發行期限之不同分為甲、乙券。甲券五年期，發行金額新臺幣貳拾億元整；乙券七年期，發行金額新臺幣肆拾億元整。每張面額為新臺幣壹仟萬元整壹種。
3. 公司債之利率：本公司債甲券票面利率固定年利率 1.68%；乙券票面利率固定年利率 1.75%。
4. 公司債償還方法及期限：本公司債各券皆自發行日起屆滿到期日乙次償還本金。
5. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之償還資金將由自有資金、銀行借款、貨幣市場工具或資本市場工具支應，並於還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構「中國信託商業銀行股份有限公司代理部」備付到期本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6. 公司債募得價款之用途及運用計畫：擴建廠務設施及購買機器設備等資本支出，

資金運用計畫詳本公開說明書第3至7頁。

7. **前已募集公司債者，其未償還之數額：**截至民國112年6月30日止公司債未償還餘額共計新臺幣12,000,000仟元整。(截至民國112年9月5日止，公司債未償還餘額共計新臺幣12,000,000仟元整。)
8. **公司債發行價格或最低價格：**依票面金額十足發行。
9. **公司股份總數與已發行股份總數及其金額：**截至民國112年6月30日止，章程所定資本總額為新臺幣33,000,000仟元整，分為3,300,000仟股，每股面額新臺幣壹拾元整；實收資本總額為新臺幣16,389,822,670元整，分為1,638,982,267股。
10. **公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：**截至112年6月30日，全部資產減去全部負債餘額為新臺幣41,367,481仟元。
11. **證券管理機關規定之財務報表：**不適用。
12. **公司債權人之受託人名稱及其約定事項：**本公司債由中國信託商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間簽訂之受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
13. **代收款項之銀行或郵局名稱及地址：**不適用。
14. **有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：**凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
15. **有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：**不適用。
16. **有發行保證人者，其名稱及證明文件：**不適用。
17. **對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：**無。
18. **可轉換股份者，其轉換辦法：**不適用。
19. **附認股權者，其認購辦法：**不適用。
20. **董事會之議事錄：**請參閱附錄之董事會會議紀錄。
21. **公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：**無。
22. **長期發行人信用評等：**
 - (1) 信用評等機構：中華信用評等公司
 - (2) 信用評等日期：112年4月27日
 - (3) 信用評等：twA+
23. **擔保方式：**無。
24. **債券形式：**本公司債採無實體發行。
25. **公司債之簽證機構及約定事項：**本公司債採無實體發行。
26. **還本付息代理機構名稱：**中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
27. **通知方式：**有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。

1. 本次發行公司債之可行性評估：

本次發行係參酌資本市場接受度及公司未來營運狀況訂定，且本次發行普通公司債之承銷方式係採承銷商全數包銷，並以洽商銷售方式對外公開承銷，應可確保完成

本次資金募集，故本次募集資金計畫應屬可行。

2. 本次發行公司債之必要性評估：

因應公司長期成長所需，公司持續擴建廠務設施及購買機器設備以支應產能擴充與因應產品組合調整等資本支出以增加公司整體營運效益。由於金融市場利率處於升息後高檔區，銀行借款成本相對在高點且資金來源穩定性不如發行公司債，目前發行普通公司債總成本仍處相對優勢，基於營運風險考量，此時鎖定長期穩定資金成本發行普通公司債應屬必要。

3. 本次發行公司債之合理性評估：

本次發行公司債採固定利率發行，可降低利率波動風險、鎖定中長期資金成本，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

名稱	有利因素	不利因素
1.銀行借款	1.資金調度運用彈性較大，到期有展延空間。 2.程序相對簡便，公司取得資金迅速。 3.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 4.利息可產生節稅效果。	1.利息負擔高於股權相關的籌資工具，將使負債部位增加，利息費用會影響公司獲利。 2.融通期限通常較短，不利於長期資金取得。 3.浮動利率，無法鎖定長期資金成本。
2.普通公司債	1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2.公司債債權人不會對公司經營之掌控帶來潛在威脅。 3.可取得中、長期穩定之資金。 4.債息列為費用，有節稅效果。	1.利息負擔高於股權相關的籌資工具，將使負債部位增加，利息費用會影響公司獲利。 2.債券到期後，公司即面臨還債之資金壓力。
3.轉換公司債	1.因其附有轉換權利，一般票面利率較低，資金成本亦較低。 2.轉換公司債之轉換價格，一般皆較發行轉換公司債時之普通股時價為高，相當以較高價格溢價發行股票。 3.可避免股權急劇稀釋。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由負債變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。	1.轉換後將稀釋每股盈餘及股權。 2.未全數轉換前，性質仍為負債，公司仍須支付利息，財務結構無法改善。 3.轉換公司債若到期時無人轉換，或債權人要求贖回時，本金無法展延，公司將面臨較大資金壓力。 4.如為海外可轉換公司債，係屬外幣計價工具，公司須定期進行評價損益，將會造成當期損益的波動度增加。
4.海外存託憑證(GDR 或 ADR)	1.提升發行公司國際知名度。 2.發行價格一般趨近於發行海外存託憑證時點之普通股價格，可籌集較多資金。 3.募資對象以國外法人為主，可免增資新股或老股釋出致國內籌碼膨脹太多，對股價產生不利影響。	1.公司國際知名度高低及其產業未來展望將左右資金募集計劃成功與否。 2.固定發行成本較高，為達成規模經濟效益，募資額度不宜過低，缺乏彈性。 3.稀釋每股盈餘及股權。

名稱	有利因素	不利因素
	4.可增加自有資本比率，改善財務結構。 5.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	4.無節稅效果。
5.現金增資	1.降低負債比率，強化財務結構，減少利息支出，提升競爭力，避免財務風險。 2.員工依法得優先認購 10%~15%，員工成為公司股東之一份子，可提高員工對公司之認同感及向心力。 3.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1.股本膨脹速度快，將直接稀釋每股盈餘及股權。 2.對股權較不集中的公司，其經營權易受威脅。 3.無節稅效果。

(2) 對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可降低利率波動風險、鎖定中長期固定資金成本、避免經由現金增資或可轉換公司債方式所導致的每股盈餘及股權稀釋問題。

(四) 本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議，並參考財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公佈之殖利率曲線與同期期指標公債暨同期期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

1. 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：

(1) 資金運用概算：

單位：新臺幣佰萬元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度													
			112 年度		113 年度				114 年度				115 年度			
			Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
擴建廠務設施及購置機器設備等資本支出	115 年第 4 季	6,000	1,000	500	400	400	400	300	400	400	400	300	400	400	400	300
合計		6,000	1,000	500	400	400	400	300	400	400	400	300	400	400	400	300

註：上述預定資金運用進度表係以本次募集公司債新臺幣 6,000,000 千元為編製基礎。

- (2) 預計可增加之產銷量、值、毛利、營業淨利及資金回收年限(表列資料以計畫之預計可能產生效益年度起至預計可收回資金年限止)：

單位：千片，金額：新臺幣億元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售值	毛利	營業淨利
112	晶圓	88	65	14	6	4
113	晶圓	179	179	48	17	11
114	晶圓	278	278	72	26	17
115	晶圓	324	324	82	29	20
116	晶圓	328	328	82	29	20
117	晶圓	332	332	81	29	19

註1：預估資金回收年限6年。

註2：本公司持續為因應客戶需求產品組合調整並擴充產能，自112年起即執行此一產能持續性發展計畫，故本次計畫項目所產生產銷量、值效益於112年度起逐步增加，並依產品生命週期對銷售量值做適當預估，預估至117年營業淨利達新台幣9,100,000千元。

(3) 產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：本公司債發行金額60億元，用於擴建廠務設施及購買機器設備等資本支出，係以增加產銷量值為主要營運目的，非針對個別產品品質改善或其他可能產生之效益，故不另作評估。

2. 轉投資其他公司者應列明事項：不適用。

3. 充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：不適用。

4. 如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。

5. 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股：不適用。



世界先進積體電路股份有限公司 第十屆第十三次董事會議事錄

- 一、時間：2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 1 時整
- 二、地點：新竹科學園區園區三路 123 號 A102 本公司會議室
- 三、出席董事 8 人：方略、曾繁城、劉文正、金聯舫、史欽泰、陳良基、魏永篤、蘇來守（委託董事方略代理）
- 四、列席人員：總經理尉濟時、副總經理陳姿鈞、副總經理暨財務長黃惠蘭、副總經理葉慶煌、副總經理郭昭仁、法務長/公司治理主管林慧蓉、協理劉國洲、協理劉醇明、協理廖志成、協理張永政、會計處長梁文穎、內稽處長岳永祺、行政院國家發展基金管理會李嘉鑫、紀錄李孟玲（報告事項第一案至第十案及承認事項至討論事項第三案）、紀錄向慧娟（報告事項第十一案及討論事項第四案至第六案）
- 五、主席：董事長 方略
- 六、主席宣佈會議開始及致詞：（略）
- 七、報告事項：（第一案至第十一案略）
- 八、承認事項：（第一案至第二案略）
- 九、討論事項：（第一案至第二案及第四案至第六案略）

第三案：提請本會議決同意本公司得於不超過新台幣 90 億元範圍內分次募集無擔保普通公司債。

說明：

1. 本公司於 2021 年 8 月 2 日與 2021 年 12 月 10 日分別經董事會核准通過在不超過新台幣 50 億元範圍內與在不超過新台幣 70 億元範圍內於國內市場募集新台幣無擔保普通公司債，均用以支應產能擴充計畫增加營運效益，及綠色環保相關之資本支出以推動綠色製造及節能減碳。故，2021 年 10 月 6 日與 2022 年 3 月 29 日本公司分別完成發行 110 年度與 111 年度國內第 1 次無擔保普通公司債，發行總額共計新台幣 120 億元。
2. 為持續擴建廠務設施及購買機器設備以支應產能擴充計畫與因應產品組合調整等資本支出以增加公司整體營運效益，得在不超過新台幣 90 億元範圍內，分次發行不超過十年期之無擔保普通公司債。債券發行相關評估內容詳如附件。
3. 依公司法第 246 條規定，公司經董事會決議後，得募集公司債；並應於公司債募集完成後向股東會報告相關事項。本案經董事會同意後，擬向主管機關申報募集無擔保普通公司債，取得申報生效函完成募集後，將向櫃買中心申請債券櫃檯買賣。
4. 因資本市場籌資環境變化快速，為提高資金募集之彈性並掌握發行時效，本案所定之發行條件（包括發行總額、年期、票面利率、還本作業等）、資金來源、計畫項目及預定進度、預計可能產生效益與相關事項，擬呈請核



准授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要決定辦理並簽署發行相關合約及文件。如遇有法令變更、經主管機關要求等變更或補充發行相關內容，或有任何未盡事宜等，亦授權董事長或其指定之人全權處理之。

5. 敬請鑒核。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

十、臨時動議：無

十一、散會

主席宣布散會。

主席：方 略



紀錄：李孟玲



向慧娟



承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

世界先進積體電路股份有限公司本次為發行112年度國內第1次無擔保普通公司債，總金額為新臺幣陸拾億元整，每張面額為新臺幣壹仟萬元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，世界先進積體電路股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

世界先進積體電路股份有限公司

凱基證券股份有限公司

負責人：許道義

承銷部門主管：林能顯



中 華 民 國 112 年 9 月 8 日

聲 明 書

本公司受世界先進積體電路股份有限公司委託，擔任世界先進積體電路股份有限公司募集與發行112年度國內第1次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、世界先進積體電路股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：許道義

日 期：112年9月8日





世界先進積體電路股份有限公司



董事長：方 略

僅供世界先進積體電路(股)公司發行 112 年度國內第 1 次無擔保普通公司債公開說明書使用